

# Lasertec News 19

株 主 通 信 第 5 6 期 (2017年7月1日～2018年6月30日)

新中期経営計画フェーズⅢ始動  
成長スピードを加速させ、さらなる飛躍を目指します



Lasertec

証券コード6920

## 社長 Q & A

2018年6月期(当期)は、前期に引き続き、売上、利益、受注、受注残、すべての面で過去最高を更新しました。半導体産業の成長と技術革新の波を捉え、新中期経営計画フェーズⅢで大きく飛躍するための準備を進めることができました。

代表取締役社長  
岡林 理



Q1

当期の業績についてどう評価されますか。市場環境と併せてお話しください。

A1

好調な市場環境にも恵まれ、前期に続き、売上、利益ともに過去最高を更新できました。

半導体市場においては、総じてメモリーメーカーの投資が活発であり、大手ファウンドリも回路線幅が10nmから7nmノードへ対応する設備投資を継続しました。このような環境下、当社は大手ファウンドリ向けを中心に、半導体マスク欠陥検査装置の

売上が好調でした。また、新規事業として注力しているウエハ関連の検査装置の売上が拡大しました。

当期の業績は、売上高212億52百万円(前連結会計年度比23.0%増)、営業利益56億85百万円(同16.0%増)、経常利益57億6百万円(同14.9%増)、

## 連結業績ハイライト

売上高	受注高	営業利益	当期純利益*
21,252 百万円	42,880 百万円	5,685 百万円	4,366 百万円
前連結会計年度比	前連結会計年度比	前連結会計年度比	前連結会計年度比
23.0% 	69.4% 	16.0% 	23.5% 

\* 親会社株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益 43 億 66 百万円 (同 23.5% 増) となりました。

受注面では、次世代の露光技術である EUVL (極端紫外線リソグラフィ) 関連製品の受注が大きく

伸びるとともに、半導体関連の新製品で大型受注を得たため、当期受注額は前期をさらに大きく上回る 428 億 80 百万円 (同 69.4% 増) を達成しました。

## Q2

当期で新中期経営計画フェーズIIが終了しました。

フェーズ0からフェーズIIの9年間を振り返ってどのように評価されますか？

## A2

新中期経営計画は、リーマンショックの影響を受け赤字に陥った2009年6月期(47期)を踏まえ、いかに会社を立て直すかを考え、48期を初年度とする計9カ年(後に12カ年に延長)の経営計画として策定したものです。この9年間で、計画前に比べ売上で2倍以上、時価総額で10倍以上と、当社は大きく成長することができました。

フェーズ0(48~50期)では、まず赤字からの脱却が最重要課題でした。経費の見直しと削減を行い、同時に原価管理を徹底しました。一方で組織改革に取り組み、半導体、液晶、顕微鏡と分かれて

いた組織の垣根を取り払い、技術部門を一つに集約することで、技術者間のコミュニケーションが改善され、人材の適正配置を行えるようになりました。事業面では、「当社の強さが発揮でき、我々が成長

できる分野に経営資源を集中する」方針のもと、半導体関連事業を中核事業と位置付けてリソースを集中させました。このような取り組みにより、3年目の50期には営業利益率が25%となり収益性は大幅に改善しました。

この間には、台湾地域での販売、サポート力強化のため現地法人Lasertec Taiwan, Inc.を設立、また、パワー半導体用材料として注目を集めているSiCウェハの欠陥検査/レビュー装置SICA61を製品化するなど、新たな成長のための種まきも行いました。

フェーズⅠ(51～53期)の3年間は、「新たな挑戦」の時期と位置付け、「コアビジネスの強化」と「新規事業の柱を立ち上げる」を目標としました。

「コアビジネス」では、それぞれの市場において革新的で競争力のあるモデルを発表できました。半導体マスク欠陥検査装置では、高い解像度を持つMATRICS X810/X810HiTを発表、半導体メーカーのウェハファブにおける検査用途で大きな市場シェアを取ることができました。半導体マスクブランクス欠陥検査装置では、より短波長のレーザー光源を採用したMAGICS M8350/M8351を発表し、業界スタンダードの地位をゆるぎないものとししました。

「新規事業」では、半導体の新たなプロセスやアプリケーションの潮流を捉えて、積極的に新製品のマーケティングと開発を行いました。この期間に、先端メモリーのウェハ面内の均一性を高速で検査するリソグラフィプロセス検査装置LX330や、3次元積層デバイスのTSV(貫通電極)工程での

ウェハ裏面研磨プロセス測定装置BGM300を発表し、新たな市場を開拓しました。加えて、EUVL技術の開発が進む中、新たなニーズに着目したEUVマスク裏面検査/クリーニング装置BASICを発表しました。新規事業領域への進出としては、リチウム電池の充放電中の電気化学反応を可視化するECCS B310を発表しました。BASICが電子デバイス産業新聞の「半導体・オブ・ザ・イヤー」を、ECCS B310が日刊工業新聞の「十大新製品賞」をそれぞれ受賞するなど、広く当社製品の革新性や技術力が認められました。

当社は2013年3月に東証一部銘柄に指定され、また53期の配当より連結配当性向の目安を従来の30%から35%に引き上げ、株主さまの期待にお応えしました。

フェーズⅡ(54～56期)の3年間は、「新規事業の基盤を確立する」時期と位置付けました。

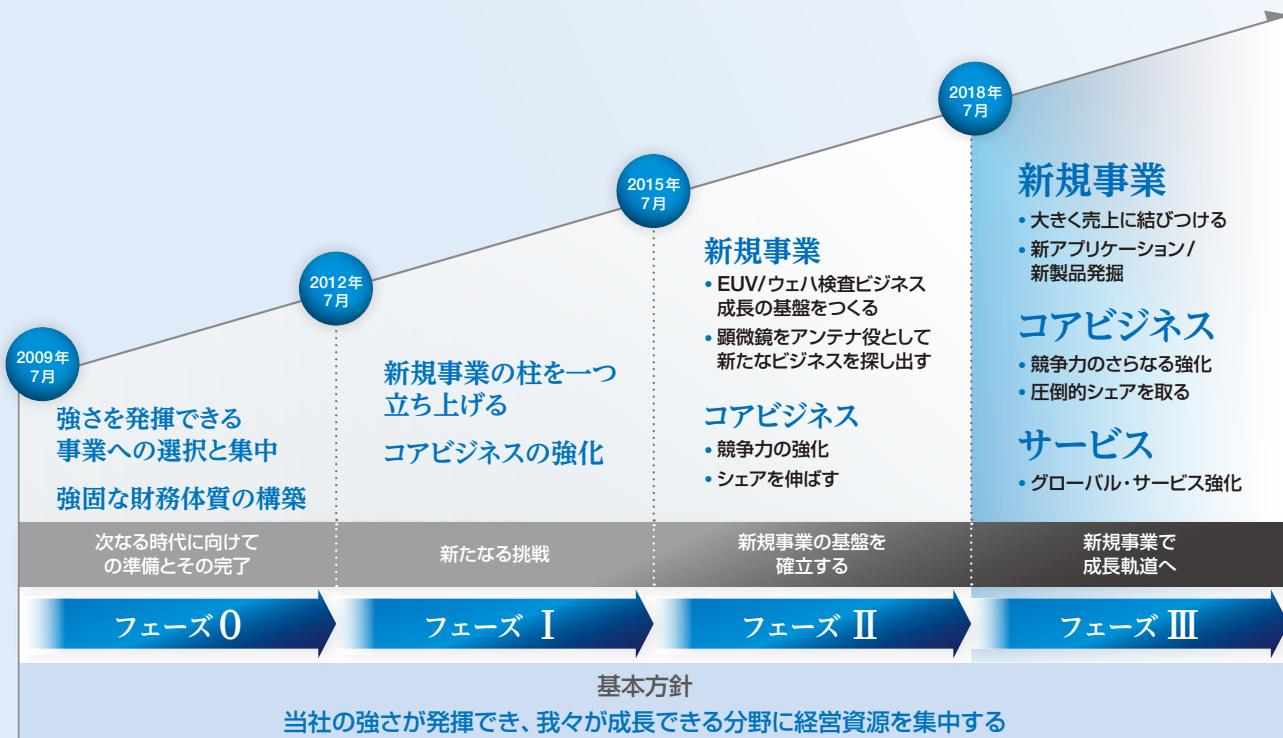
この期間「コアビジネス」では、半導体マスク欠陥検査装置において着実に市場シェアを拡大できました。2016年、最先端の10nm～7nmノードに対応したMATRICS X810EXを市場投入し、2018年には間近に迫ったEUVリソグラフィの実用化に備え、従来のフォトマスクとEUVマスクの両方が検査できるモデルX8ULTRAを発表しました。FPD分野では、10.5世代と呼ばれる超大型パネルを量産するFPDパネル製造工場が中国で相次ぎ建設されることを受け、高感度でかつ10.5世代パネル用マスクにも対応するCLIOS G1001を発表しました。

「新規事業」では、ウェハエッジ検査装置EZ300

やSiCウェハ欠陥検査/レビュー装置の新モデルSICA88を発表し、新規事業のラインアップを拡充しました。またEUVL関連製品を新規ビジネスの柱とすべく、2017年にEUVマスクブランクス欠陥検査/レビュー装置ABICS E120を発表、すでに複数台の受注を獲得しています。ABICS E120は、日刊工業新聞や電子デバイス産業新聞の賞を受賞し、世界初の13.5nmのEUV光源を用いた画期的な検査装置として世の中に認められました。

この期間、大きな成長が見込まれる中国市場における当社製品のサポート強化を目的に、現地法人Lasertec China Co., Ltd.を設立しました。また、56期より中間配当の実施を始め、より株主さまへの利益還元之机を充実させました。

このように振り返ると、9年の間にいろいろなことがありましたが、高収益体質へと変革し、売上、利益を順調に伸ばすことができ、大きな成果を挙げることができたと考えます。



### Q3

2019年6月期(今期)はいよいよフェーズⅢが始まります。フェーズⅢでの目標を教えてください。

### A3

半導体産業は今後さらに大きな変化と成長を遂げることが予想されます。この市場の大きな変化を捉え、飛躍を目指します。

仮想通貨マイニングやフィンテックで重要となるHPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)、5G(第5世代移動通信システム)、AI(人工知能)、IoT(さまざまなものがインターネットにつながる)、ADAS(先進運転支援システム)などの需要が高まり、これらの新技術には莫大な量の半導体が使われることから、半導体の需要は将来にわたって加速度的に増大していくことが予想されます。

この成長する半導体市場で、さらに伸びていく先端分野に注力することで、成長する市場の中でも

より大きな成長を目指します。特にフェーズⅢの期間では、フェーズⅡまでに種まきをしたEUVL関連やウェハ検査関連の製品がいよいよ収穫期に入ります。「コアビジネス」を成長させるとともに、「新規事業」の収穫を確実なものにして、当社の躍進につなげていきたいと考えています。

さらに、製品の納入後も世界中のお客さまに安心して使っていただくために、サービス(保守)の重要性をより強く認識しており、グローバルに体制を強化していく方針です。

**最後に株主さまへメッセージをお願いいたします。**

おかげさまで、売上、利益、受注、受注残、すべての面で2期連続過去最高を更新することができました。フェーズⅢに入る今期以降、一層成長スピードを加速させ、株主さまのご期待に応える所存です。

レーザーテックは、どこよりも早くお客さまのご要望にお応えできる製品を開発し、お客さまに貢献すると同時に、業績の向上を目指してまいります。株主の皆さまにおかれましては、変わらぬご支援とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。



## Topic 1 | ABICS E120が「半導体・オブ・ザ・イヤー2018」でグランプリを受賞

電子デバイス産業新聞が主催する「半導体・オブ・ザ・イヤー2018」にて、EUVマスクブランクス欠陥検査/レビュー装置ABICS E120が、半導体製造装置部門でグランプリを受賞しました。2013年BASIC(グランプリ)、2016年SICA88(優秀賞)に続き、3回目の受賞となります。

本賞は、2017年4月～2018年3月の間に発表された製品・技術(バージョンアップを含む)を選考対象とし、「開発の斬新性、量産体制の構築、社会に与えたインパクト、将来性」などを基準に3部門8製品が、記者の投票により選出されています。

ABICS E120はEUVマスクブランクス欠陥管理と

歩留まりの向上に貢献する、最先端テクノロジーを結集した装置です。時代を象徴する製品として、また次世代の技術として高い評価を受け、応募製品多数の中、グランプリに選ばれました。

レーザーテックは、これからも最先端分野での装置開発を行い、産業の発展に貢献したいと考えております。



受賞式 2018年6月6日

## Topic 2 | 配当金領収証の取扱金融機関変更について

かねてより多くの株主さまよりご要望をいただいております配当金の領収証払いにつきまして、当社は株主さまの声にお応えし2018年6月期(第56期)期末配当から、取扱金融機関をゆうちょ銀行(全国本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者))に変更いたしました。

本変更に伴い、配当金をお近くのゆうちょ銀行・郵便局でお受け取りいただけるようになりました。払渡期間に関しても、以前の1カ月間から2カ月間と長くなり、また複数銘柄を保有されている株主さまにおかれましては、配当金をまとめてお受け取りいただけるなど、株主

さまの利便性向上を図りました。

これまで三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行をご利用いただいていた株主さまにはご不便をおかけすることとなりますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、配当金を配当金領収証でお受け取りの株主さまには、より安全かつ迅速なお受け取り方法として、振込指定の方法をお勧めいたします。詳細は当社Webサイト「株式事務手続きのご案内」(<https://www.lasertec.co.jp/ir/stock/outline.html>)をご覧ください。

# 業界標準機「SICA88」

## 生産性の飛躍的な 向上に貢献

取締役 技術一部/第1ソリューションセールス部 部長  
関 寛和



SiC (炭化ケイ素) パワーデバイスとは、その素材であるSiCが従来のSi (シリコン) と比較して、電力損失を数分の一に低減できる省エネ半導体として、エアコン、太陽光発電システム、電気自動車 (EV)、鉄道車両などの電力変換器に搭載され、今後の発展が大いに期待されています。SiC ウェハ欠陥検査/レビュー装置「SICA88」は、この優れた素材であるSiC ウェハを高感度で検査する装置で、発売以降国内外で売上を継続的に伸ばし、業界標準機となっています。

今後は環境規制の高まりから自動車メーカーがEV生産を増やし、世界的にEVの普及が進んでいくことが予測されます。車載用SiCパワーデバイスの世界市場も大きく拡大し、それに伴い検査装置の需要も増えていくことが見込まれます。

販売開始から  
34台受注

グローバル市場で  
トップシェアを獲得

EV普及の波に乗り、  
販売拡大へ



レーザーテックの強みは優れた技術とサービスを提供し、信頼関係を築いたお客さまからニーズや課題をつかむことで、真に役立つ製品をスピーディに開発する取り組みを徹底していることです。「SICA88」は、そのようなアプローチから生まれた競争力の高い装置です。

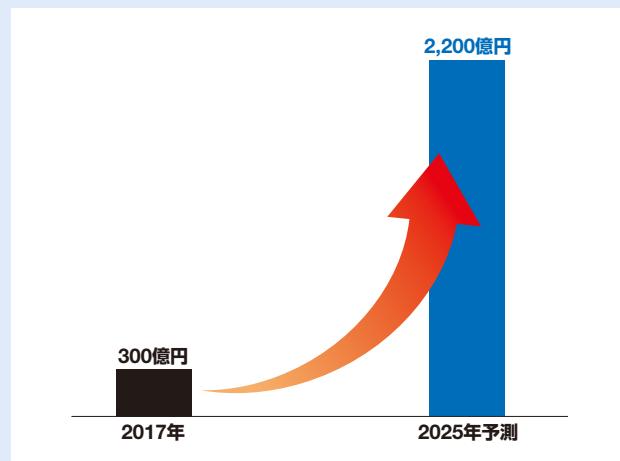
旧機種である「SICA6X」は、ウェハの品質改善やデバイスの歩留まり向上に大きく貢献し、SiCウェハ表面検査装置として業界標準の地位を固め、お客さまから高い信頼を得ていました。新機種「SICA88」は、旧機種ユーザーの「SiCウェハの表面だけでなく、内部の欠陥も高速に検出したい」という課題を解決するために開発した装置です。表面検査と内部検査を同時に実施でき、検査時間を半分に短縮させた革新的な装置で、2015年の発売後わずか一年で10台納入、累計34台を受注し、「SICA6X」に続き業界標準機の地位を確立いたしました。

我々にとって、製品の納入はゴールではなく、お客さまとの信頼関係構築の始まりです。納品した後も必要な機能などについて対話を続けることで新たなニーズを深掘りし、製品のバージョンアップを図っていくことを基本姿勢としています。当社にとって、技術力による他社との差別化は当然のことですが、納品後も生産性改善に寄与するために徹底したサポートを続けることで真のニーズを引き出し、お客さまが求める装置を提供できたことが、8割以上のシェアに結びついた要因と考えています。

「SICA88」は、SiCパワーデバイス市場の成長になくはならない装置になりました。これからも業界の発展に合わせた供給体制を整えることが、業界標準機を生み出した当社の責務だと思っています。

今後はSiCで成功したノウハウを生かし、パワーデバイス用新素材として拡大が期待されるGa<sub>2</sub>N(窒化ガリウム)やダイヤモンドなど他の素材にも着目し、生産性向上に役立つ新たな製品を開発していきたいと考えています。

## SiCパワーデバイスの世界市場



当社調べ

# 2018年6月期(第56期)の連結決算のご報告

## 連結貸借対照表(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当連結会計年度 (2018年6月30日)	前連結会計年度 (2017年6月30日)	科目	当連結会計年度 (2018年6月30日)	前連結会計年度 (2017年6月30日)
資産の部			負債の部		
流動資産	29,387	24,719	流動負債	10,779	8,328
			固定負債	288	210
			負債合計	11,068	8,539
固定資産	8,733	8,300	純資産の部		
			株主資本	26,799	24,237
			① 純資産合計	27,053	24,479
資産合計	38,121	33,019	負債純資産合計	38,121	33,019

## 連結損益計算書(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当連結会計年度 (自2017年7月1日 至2018年6月30日)	前連結会計年度 (自2016年7月1日 至2017年6月30日)
② 売上高	21,252	17,278
売上原価	9,251	7,808
売上総利益	12,001	9,469
販売費及び一般管理費	6,315	4,568
③ 営業利益	5,685	4,901
③ 経常利益	5,706	4,964
③ 親会社株主に帰属する当期純利益	4,366	3,534

## 連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当連結会計年度 (自2017年7月1日 至2018年6月30日)	前連結会計年度 (自2016年7月1日 至2017年6月30日)
④ 営業活動による キャッシュ・フロー	2,916	3,495
投資活動による キャッシュ・フロー	△684	△612
財務活動による キャッシュ・フロー	△1,805	△1,151
現金及び現金同等物の 期首残高	9,736	7,967
現金及び現金同等物の 期末残高	10,107	9,736

## 決算のポイント

### ① 純資産合計

株主資本にその他の包括利益累計額および新株予約権を加えた純資産合計は、270億53百万円となりました。自己資本比率は70.9%で、引き続き財務の健全性を維持しています。また、ROE(自己資本当期純利益率)は17.0%、ROA(総資産当期純利益率)は12.3%となりました。

### ② 売上高

半導体マスク欠陥検査装置が引き続き好調で、売上高が初めて200億円を超え、過去最高額を更新しました。

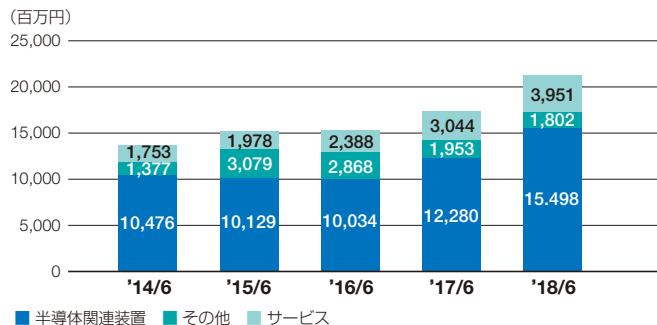
### ③ 利益

営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益も過去最高益を更新しました。

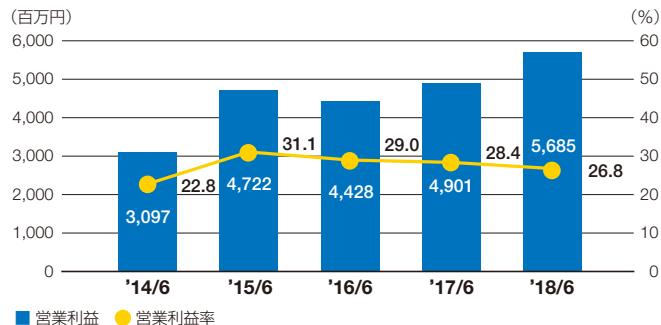
### ④ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益、前受金の増加などの収入要因が、たな卸資産の増加、法人税等の支払いなどの支出要因を上回りました。

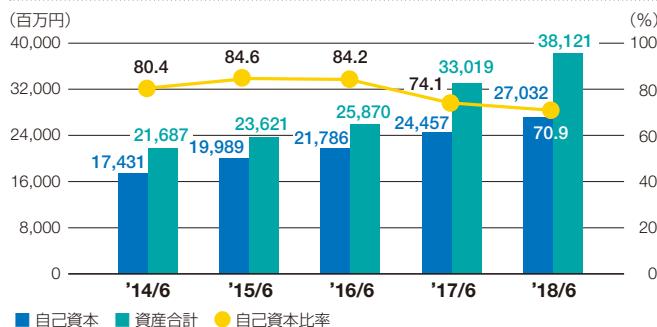
## 製品別売上高



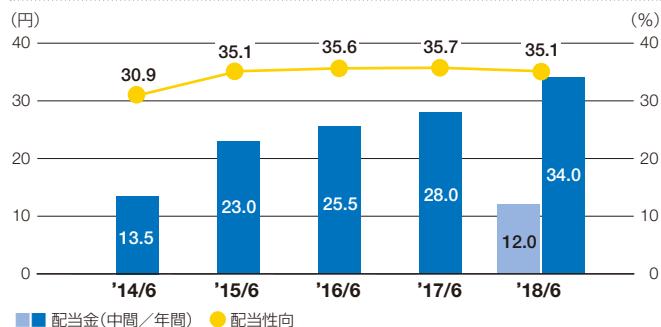
## 営業利益・営業利益率



## 自己資本・資産合計・自己資本比率

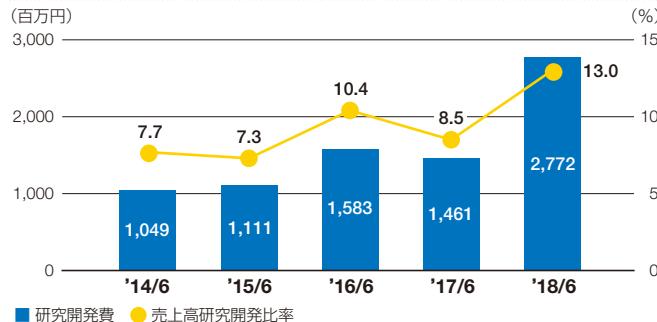


## 1株当たり配当金・配当性向

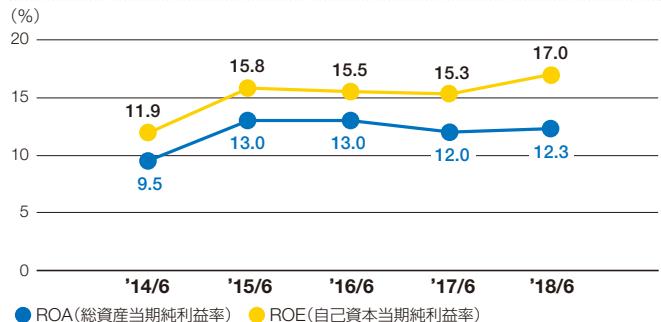


※2017年4月1日付け、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。そのため、2014年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、上記の金額を算定しています。また、会計方針の変更に伴い遡及修正が行われたため、2017年6月期配当性向は、遡及修正後の数値を用いて算出しています。

## 研究開発費・売上高研究開発比率



## ROA・ROE



※2018年6月期の会計方針の変更に伴い、2017年6月期の決算数字を遡及適用し変更しています。

## 会社概要 (2018年6月30日現在)

社名	レーザーテック株式会社
所在地	〒222-8552 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番地1
設立	1962年8月
資本金	9億3,100万円
主な事業内容	下記製品の開発・製造・販売・サービス 1. 半導体関連装置 2. エネルギー・環境関連製品 3. レーザー顕微鏡関連製品 4. FPD関連装置
従業員数	連結 332名 単体 232名
お問い合わせ先	045-478-7127 (経営企画室)

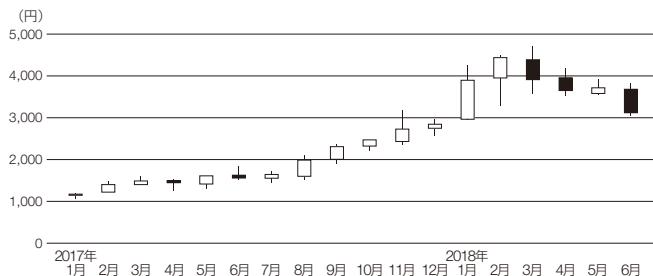
## 株式情報 (2018年6月30日現在)

### 株式概要

上場市場	東京証券取引所市場第一部
発行済株式総数	47,143,200株
株主数	8,173名
大株主一覧	
	持株数(千株) 持株比率(%)
BBH FOR MATTHEWS JAPAN FUND	2,123 4.70
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2,009 4.45
内山 靖子	2,003 4.44
内山 洋	1,741 3.86
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,697 3.76
株式会社三菱UFJ銀行	1,504 3.33
内山 秀	1,394 3.09
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1,360 3.01
前田 せつ子	1,293 2.86
UCHIYAMA HOLDINGS株式会社	807 1.79

(注)1. 当社は、自己株式を2,054,078株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。また持株比率は、自己株式を控除して計算しております。  
2. 持株数・持株比率は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

### 株価の推移



(注)当社は2017年4月1日付けで、普通株式1株を2株に分割いたしました。  
上記グラフは、2017年1月から当株式分割が行われたと仮定して算出した株価の推移です。

## 役員 (2018年9月26日現在)

代表取締役社長 岡林 理	社外取締役 梶川 信宏 海老原 稔 下山 隆之
代表取締役副社長 楠瀬 治彦	常勤監査役 塚崎 健明
常務取締役 内山 秀	監査役 齋藤 侑二 石黒 美幸
取締役 森泉 幸一 関 寛和	

## 株主メモ

事業年度 7月1日から翌年6月30日まで  
定時株主総会 毎年9月  
基準日 毎年6月30日 (なお、その他必要あるときは、あらかじめ公告した日)

単元株式数 100株  
株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社  
特別口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
東京都府中市日鋼町1-1  
電話 0120-232-711 (通話料無料)  
郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号  
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

公告掲載URL <https://www.lasertec.co.jp>  
ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。

(ご注意)

- 株主さまの住所変更、買取請求その他各種手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関(証券会社など)にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店においてもお取り扱いいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行の本店でお支払いいたします。

### 当社Webサイトのご案内

<https://www.lasertec.co.jp>

Webサイト「個人投資家の皆さまへ」  
をリニューアルし、内容の充実を図り  
ました。ぜひご覧ください。

企業ホームページ  
優秀サイト  
2017  
日経アワード  
総合ランキング

